提案書

＜提案企業概要＞

※以下の記載欄は、必要に応じて枠の大きさを調整してください。

※秘密情報は一切含めないでください。

|  |  |
| --- | --- |
| ①貴社名 | ●●●●株式会社 |
| ②所在地 | （郵便番号）〒●●●-●●●● |
|  | （住所）●●● |
| ③資本金 | ●●●円 |
| ④従業員数 | ●●名（●年●月時点） |
| ⑤主要事業の内容 | ※貴社のパンフレットやカタログがございましたら、URLをご記入ください。（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） |
| ⑥貴社HPのURL |  |
| ⑦本技術交流会の担当者連絡先 | 1 | 役職 |  |
|  |  | 氏名 |  |
|  |  | TEL |  |
|  |  | E-Mail |  |
|  | 2 | 役職 |  |
|  |  | 氏名 |  |
|  |  | TEL |  |
|  |  | E-Mail |  |
|  | 3 | 役職 |  |
|  |  | 氏名 |  |
|  |  | TEL |  |
|  |  | E-Mail |  |
| ⑧これまでの半導体関連事業の実績 |[ ]  実績あり |[ ]  実績なし |
| ⑨所属している半導体関連協議会・コンソーシアム※該当欄に☑をお付けください。 |[ ]  北海道半導体人材育成等推進協議会 |
|  |[ ]  東北半導体・エレクトロニクスデザインコンソーシアム(T-Seeds) |
|  |[ ]  関東半導体人材育成等連絡会議 |
|  |[ ]  中部地域半導体人材育成等連絡協議会 |
|  |[ ]  関西半導体人材育成等連絡協議会 |
|  |[ ]  中国地域半導体関連産業振興協議会 |
|  | □ | 九州半導体人材育成等コンソーシアム |
|  |[ ]  九州半導体・デジタルイベーション協議会(SIIQ) |
| ⑩確認事項※右記文章をご確認の上、右欄に☑をお付けください。 |[ ]  本提案書を・技術交流会事務局、ニーズ発信企業に提供すること・所属している半導体関連協議会・コンソーシアムに提供する場合があることをいずれも承諾いたします。 |

【提案内容①】

※以下の記載欄は、必要に応じて枠の大きさを調整してください。

※必要に応じて画像、図、表などを挿入してください。

※資料のページ数については、１つの提案内容につき４ページ以内で記載してください。

１．提案技術・製品が、「応募要領（別紙）」に記載されたどのニーズ（求められるキーワード）に対応したものか選択してください。重複選択も可能です。

※ニーズ（求められるキーワード）に対応していない場合は「その他（自由記述）」を選択してください。

|  |  |
| --- | --- |
| ニーズ（求められるキーワード） |[ ]  低コスト |
|  |[ ]  生産性改善 |
|  |[ ]  歩留まり改善 |
|  |[ ]  省エネ |
|  |[ ]  安全性 |
|  | □ | ほかにはない独自技術 |
|  |[ ]  その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） |

2．提案技術・製品に関するテーマ/タイトルを「簡潔」に（30文字以内で）、ご記載ください。

|  |
| --- |
| （記載例）～～を効率化します！ ～～を革新します！ これまでにない～～！ 消費電力を●％削減します！ |
|  |

3．提案技術・製品の概要、特徴・既存技術・製品と比較した場合の優位性・実現方法、採用・導入実績、開発状況・研究段階、知的財産権の状況等をご記載ください。

※全ての項目に記載していただく必要はなく、可能な範囲で記載をお願いします。

※その他自由に項目を追加いただいても結構です。

|  |  |
| --- | --- |
| 概要 |  |
| 特徴・既存技術・製品と比較した場合の優位性・実現方法(材料・加工・組立・計測方法等) |  |
| 採用・導入実績 |  |
| 開発状況・研究段階 |  |
| 知的財産権の状況 |  |
| 販売ロット・単価・費用対効果 |  |

4．提案技術・製品の用途方法、用途場面等、技術・製品の用途イメージをご記載ください。

|  |
| --- |
| （記載例）～～～の場面で、～～～のように利用することで、～～～の結果が見込まれる。～～～の工程の～～～で利用することで効率化が図られる。 |
|  |

5．これまでの半導体関連事業の実績など、アピールしたい内容があれば自由にご記載ください。

※半導体関連企業との取引実績、受賞歴、取組年数、技術を活用した製品例、提案技術の優位性など、保有技術のアピールになる点がありましたら、極力ご記載ください。

|  |
| --- |
|  |

6．これまでの半導体関連事業以外の実績など、アピールしたい内容があれば自由にご記載ください。

|  |
| --- |
|  |

７．その他、特筆すべき事項があれば記載ください。（要望等、全てにお応えできない場合もございます）

|  |
| --- |
|  |

【提案内容②】　*提案内容が複数ある場合は、２つ目の提案内容をこのシートにご記載ください*

※以下の記載欄は、必要に応じて枠の大きさを調整してください。

※必要に応じて画像、図、表などを挿入してください。

※資料のページ数については、１つの提案内容につき４ページ以内で記載してください。

１．提案技術・製品が、「応募要領（別紙）」に記載されたどのニーズ（求められるキーワード）に対応したものか選択してください。重複選択も可能です。

※ニーズ（求められるキーワード）に対応していない場合は「その他（自由記述）」を選択してください。

|  |  |
| --- | --- |
| ニーズ（求められるキーワード） |[ ]  低コスト |
|  |[ ]  生産性改善 |
|  |[ ]  歩留まり改善 |
|  |[ ]  省エネ |
|  |[ ]  安全性 |
|  | □ | ほかにはない独自技術 |
|  |[ ]  その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） |

2．提案技術・製品に関するテーマ/タイトルを「簡潔」に（30文字以内で）、ご記載ください。

|  |
| --- |
| （記載例）～～を効率化します！ ～～を革新します！ これまでにない～～！ 消費電力を●％削減します！ |
|  |

3．提案技術・製品の概要、特徴・既存技術・製品と比較した場合の優位性・実現方法、採用・導入実績、開発状況・研究段階、知的財産権の状況等をご記載ください。

※全ての項目に記載していただく必要はなく、可能な範囲で記載をお願いします。

※その他自由に項目を追加いただいても結構です。

|  |  |
| --- | --- |
| 概要 |  |
| 特徴・既存技術・製品と比較した場合の優位性・実現方法(材料・加工・組立・計測方法等) |  |
| 採用・導入実績 |  |
| 開発状況・研究段階 |  |
| 知的財産権の状況 |  |
| 販売ロット・単価・費用対効果 |  |

4．提案技術・製品の用途方法、用途場面等、技術・製品の用途イメージをご記載ください。

|  |
| --- |
| （記載例）～～～の場面で、～～～のように利用することで、～～～の結果が見込まれる。～～～の工程の～～～で利用することで効率化が図られる。 |
|  |

5．これまでの半導体関連事業の実績など、アピールしたい内容があれば自由にご記載ください。

※半導体関連企業との取引実績、受賞歴、取組年数、技術を活用した製品例、提案技術の優位性など、保有技術のアピールになる点がありましたら、極力ご記載ください。

|  |
| --- |
|  |

6．これまでの半導体関連事業以外の実績など、アピールしたい内容があれば自由にご記載ください。

|  |
| --- |
|  |

７．その他、特筆すべき事項があれば記載ください。（要望等、全てにお応えできない場合もございます）

|  |
| --- |
|  |

【提案内容③】　*提案内容が複数ある場合は、３つ目の提案内容をこのシートにご記載ください*

※以下の記載欄は、必要に応じて枠の大きさを調整してください。

※必要に応じて画像、図、表などを挿入してください。

※資料のページ数については、１つの提案内容につき４ページ以内で記載してください。

１．提案技術・製品が、「応募要領（別紙）」に記載されたどのニーズ（求められるキーワード）に対応したものか選択してください。重複選択も可能です。

※ニーズ（求められるキーワード）に対応していない場合は「その他（自由記述）」を選択してください。

|  |  |
| --- | --- |
| ニーズ（求められるキーワード） |[ ]  低コスト |
|  |[ ]  生産性改善 |
|  |[ ]  歩留まり改善 |
|  |[ ]  省エネ |
|  |[ ]  安全性 |
|  | □ | ほかにはない独自技術 |
|  |[ ]  その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） |

2．提案技術・製品に関するテーマ/タイトルを「簡潔」に（30文字以内で）、ご記載ください。

|  |
| --- |
| （記載例）～～を効率化します！ ～～を革新します！ これまでにない～～！ 消費電力を●％削減します！ |
|  |

3．提案技術・製品の概要、特徴・既存技術・製品と比較した場合の優位性・実現方法、採用・導入実績、開発状況・研究段階、知的財産権の状況等をご記載ください。

※全ての項目に記載していただく必要はなく、可能な範囲で記載をお願いします。

※その他自由に項目を追加いただいても結構です。

|  |  |
| --- | --- |
| 概要 |  |
| 特徴・既存技術・製品と比較した場合の優位性・実現方法(材料・加工・組立・計測方法等) |  |
| 採用・導入実績 |  |
| 開発状況・研究段階 |  |
| 知的財産権の状況 |  |
| 販売ロット・単価・費用対効果 |  |

4．提案技術・製品の用途方法、用途場面等、技術・製品の用途イメージをご記載ください。

|  |
| --- |
| （記載例）～～～の場面で、～～～のように利用することで、～～～の結果が見込まれる。～～～の工程の～～～で利用することで効率化が図られる。 |
|  |

5．これまでの半導体関連事業の実績など、アピールしたい内容があれば自由にご記載ください。

※半導体関連企業との取引実績、受賞歴、取組年数、技術を活用した製品例、提案技術の優位性など、保有技術のアピールになる点がありましたら、極力ご記載ください。

|  |
| --- |
|  |

6．これまでの半導体関連事業以外の実績など、アピールしたい内容があれば自由にご記載ください。

|  |
| --- |
|  |

７．その他、特筆すべき事項があれば記載ください。（要望等、全てにお応えできない場合もございます）

|  |
| --- |
|  |